

证券代码：300054

证券简称：鼎龙股份

## 湖北鼎龙控股股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20230223

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他： <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位名称及人员姓名	中金公司：杨钊；博时基金：曾豪、王凌霄；民生证券：李萌、刘雨晴、邓超瑜；华夏基金：张皓智；南方基金：陈思臻
时间	2023年02月22日上午10:00~11:30
地点	公司五楼会议室
上市公司接待人员姓名	公司董事、副总经理兼董事会秘书：杨平彩
投资者关系活动主要内容介绍	<p>管理层介绍公司基本情况，并与投资者就半导体材料业务、打印复印通用耗材业务的经营及其他投资者关心的问题进行深入交流，主要交流内容如下：</p> <p><b>1.问：公司CMP抛光垫产品经营情况？</b></p> <p>答：公司是国内唯一一家全面掌握抛光垫全流程核心研发和制造技术的CMP抛光垫的国产供应商。目前公司CMP系列产品中主要包含CMP抛光垫、CMP抛光液、清洗液等主要产品。在CMP抛光垫产品方面，公司在生产端积极筹备，潜江三期抛光垫新品及其核心配套原材料的扩产项目已于去年底基本完工试产；客户端方面已经进入国内主流晶圆厂客户，市场占有率稳步提升，国内外客户扩展正在同步进行；研发端方面公司结合客户新技术需求及对未来半导体产业探索，研发了发高平坦化、高去除速率用抛光垫等新产品；供应链方面，公司坚持原材料自主化，保证关键原材料自主化持续推进，常规型号原料均实现自研自产，持续优化产品成本结构。</p> <p>从2023年年初外部情况看，产业链下游去库存情况还在继续，公司国内外晶圆厂客户处于去库存节奏中。公司将结合行业情况，力争提高客户市占率，保证产品年度上量。考虑到未来消费市场回暖，国内晶圆厂稼动率提升，公司CMP抛光垫产品2023销售规模将有一定增长的空间。</p> <p>未来CMP PAD业务将要围绕三块展开：一、今年公司市场重点更多在逻辑芯片客户体系。二、公司的抛光垫产品往大硅片和三代半导体方向拓展。公司原来的产品体系围绕晶圆展开，大硅片的抛光和三代半导体抛光垫之前没有作为重点发展，未来将陆续拓展这块的CMP环节的，包括抛光垫抛光</p>

液在内的各类产品。三、公司将持续加大新材料新产品的研发投入，保持跟与客户需求同步，做应用端的配合和产品线的丰富。

### **2.问：远期如何看待 CMP 环节相关产品市场？**

答：CMP 抛光材料是集成电路制造中至关重要的半导体材料，根据 SEMI 数据，CMP 抛光材料在集成电路制造材料成本中占比 7%，其中 CMP 抛光垫、CMP 抛光液、CMP 清洗液合计占 CMP 抛光材料成本的 85% 以上。随着国内半导体产业规模的增长和制程工艺的进步、芯片堆叠层数的增加，抛光步骤和 CMP 耗材用量将会增加，CMP 材料市场将进一步扩大。

根据 SEMI 报告，目前国内约有 23 座 12 寸晶圆厂正在生产，预计至 2026 年晶圆厂整体数量将接近翻倍，仅国内市场对 CMP 相关产品需求都将持续提升。公司对 CMP 相关产品未来增长较有信心。

### **3.问：CMP 抛光液项目进展情况。**

答：目前公司从 CMP 抛光液上游的核心原材料研磨粒子开始，已经布局多种制程系列的近 40 种 CMP 抛光液产品，在国内主要晶圆客户的导入全面展开，多种产品正在客户端验证中。同时公司实现了抛光液上游原材料的自主制备，保证了抛光液产品供应链的安全稳定。目前已在武汉本部建成了抛光液一期自动化生产车间，仙桃厂区抛光液二期扩产计划力争 23 年投产使用。整体项目进展顺利，预计 2023 年产品将有放量可能。

### **4.问：公司 CMP 相关产品是否有海外计划？**

答：公司将继续做好国内已有晶圆厂客户服务，依据客户需求，发挥自主化替代及供应链安全优势，继续提高市占率并推出新产品。同时也会按照既有计划推进海外客户的市场拓展工作。

### **6.问：公司先进封装材料的 23 年发展情况？**

答：先进封装材料是公司前瞻布局的重要发展方向。目前多款先进封装材料被国外企业垄断，供应链国产化率几乎为零，行业严重被“卡脖子”。

公司将根据市场新需求为客户提供多种类的材料及耗材。目前公司在先进封装材料领域重点布局的产品包括：用于 2.5D/3D (2.5 维，3 维)晶圆减薄工艺中使用的临时键合胶、封装光刻胶(PSPI)，以及倒装工艺的底部填充剂 (Underfill)产品。

其中临时键合胶项目进展较快，公司于去年年底完成了产线建设及试生产，已经与客户开始送样及测试工作，力争在今年开始取得销售收入。

### **7.问：公司子公司拟挂牌新三板情况？**

答：具体内容见公司公告。北海绩迅为公司打印耗材产业子公司，为国内再生墨盒细分领域龙头企业，本次挂牌将提升品牌影响力，提升北海绩迅经营能力，增强核心竞争力。北海绩迅在新三板挂牌后，仍是公司合并报表范围内控股子公司，不会影响公司对北海绩迅的控制权。长期来看利于增加公司资产的流动性，提升公司资产的市场价值。

附件清单	无
日期	2023年02月23日